

**Гордиенко Александр,  
Ведущий менеджер по продажам  
Advantech Technology LLC**



# ADVANTECH

## Миссия

Enabling an Intelligent Planet

## Оборот

USD \$1.76 Миллиарда (2019)

## Рыночная капитализация

USD\$7.07 Миллиарда (Декабрь 2019)

## Основные направления развития

Индустрия 4.0

Индустрия интернета вещей

Встроенные компьютеры

Умный город (Медицина, Розничная торговля,  
Логистика)



# Представительства по всему миру

3 Производственных центра

14 Центров по ремонту

4 Центра логистики

27 Стран

Америка  
550pp

Европа  
540pp

Китай  
3,100pp

Тайвань  
3,400pp

Сев. Азия & др.  
500pp



## MIO



# Продукция высочайшего качества и надежности

(Watt)

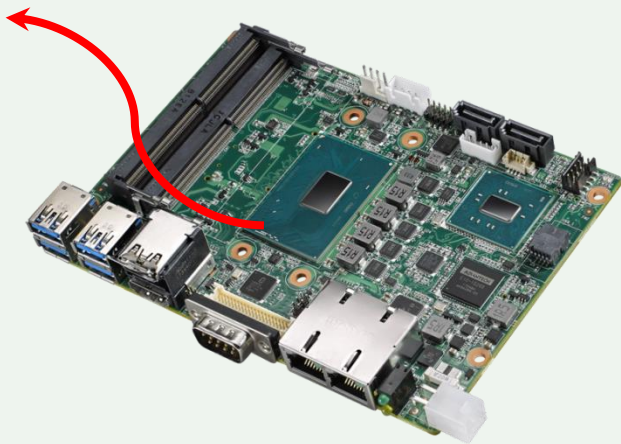
45

35

25

15

5



-40

-20

0

60

85

(°C)

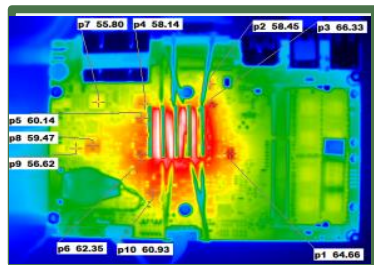


Выбор компонентов

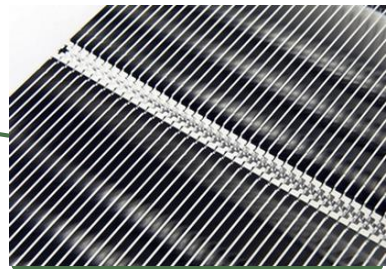
-40~85°C



Тепловое  
моделирование



Теплоотвод с  
КПД «Copper Fin»

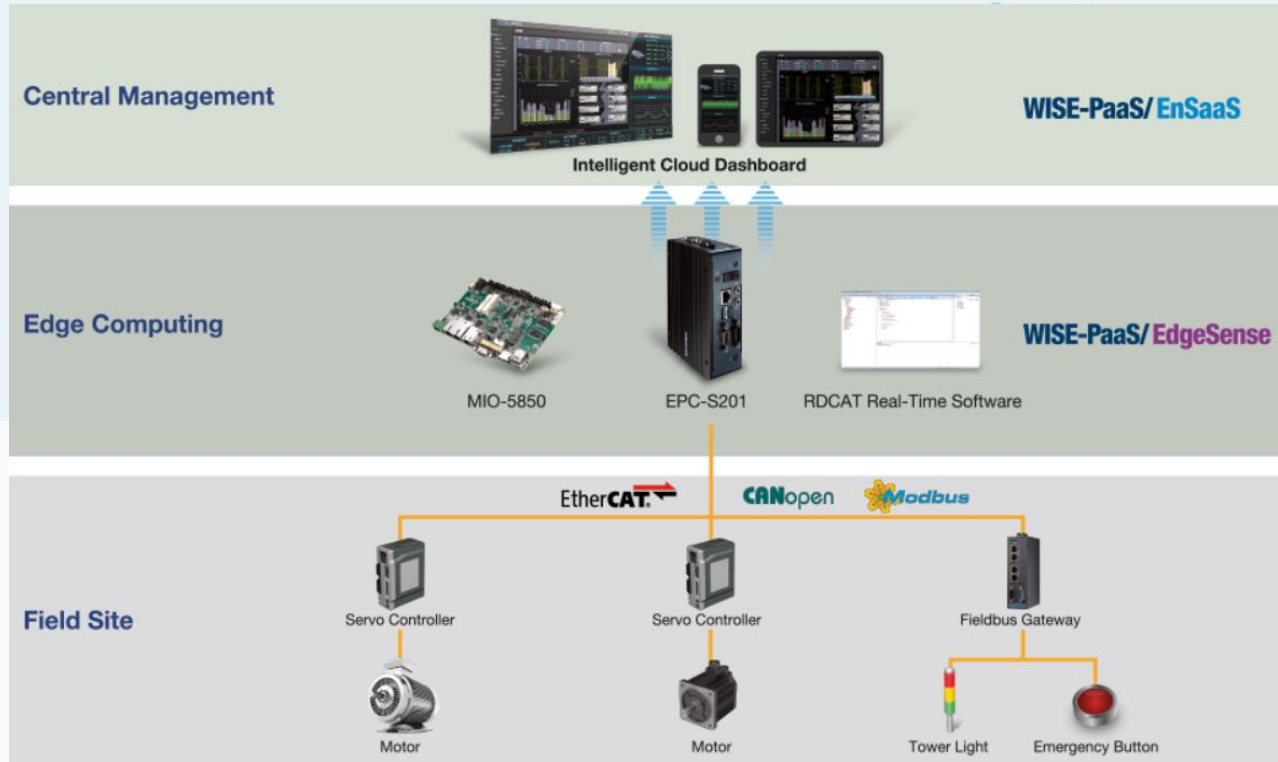
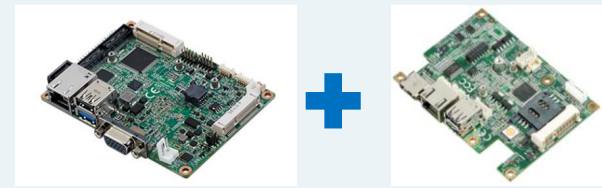


Конформное покрытие  
IPC-A610E

ADVANTECH



# Решения для управления робототехнической автоматизацией



# MIO-5393

9th/8th Gen. Intel Xeon/Core™ Processor, 3.5"  
SBC w/ MIOe

- До 6 ядер и TDP 45 Вт/35 Вт
- Двухканальный DDR4-2400, до 64 ГБ, ECC для Xeon SKU
- Тройной дисплей с 48-битным LVDS + HDMI + DP
- USB 3.1 Gen 2 (10 Гбит/с), TPM 2.0 и твердотельный накопитель NVMe/ PCIe Gen3x4
- Двойной GbE, SATAIII, RS-232/422/485, CANBus, SMBus, I2C
- M.2 B- 2280/3042, (дополнительный 2280) и M.2 E 2230
- Поддерживает API iManager 3.0 и SW, WISE Paas / DeviceOn



GPIO



SMBus/I2C



Watch Dog  
Timer



Backlight  
On/Off



Brightness



CAN bus



Hardware  
Monitor



System  
Throttling



Thermal  
Protection



Smart Fan



Data  
Security



System Info

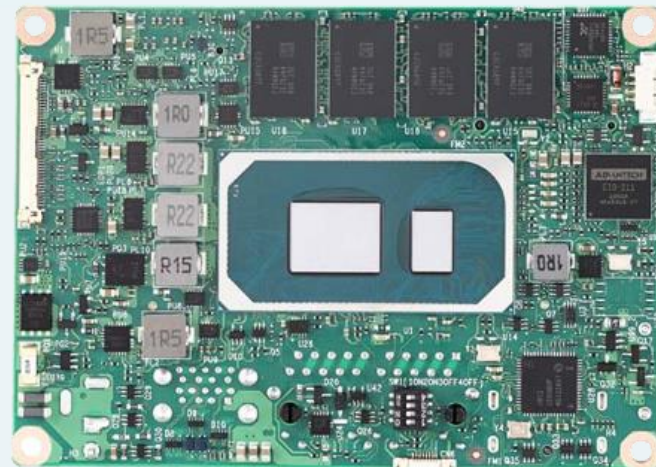


ADVANTECH

# MIO-2375

Процессор 11-го поколение Intel® Core U-series  
i7/i5/i3/Celeron Pico-ITX SBC

- Серия Intel® Tiger Lake-UP 3 (10 нм++), встроенный LPDDR4x-4266 до 32Г с IB ECC
- Двойной независимый дисплей: eDP/MIPI-DSI, DP до 8K
- Богатый интерфейс ввода-вывода с GbE x 2, USB 3.2, COM-портом, DIO SMBus, TPM2.0
- Гибкое расширение для подключения к Интернету вещей: M.2 E-Key, M.2 B-Key/M-Key NVMe x2
- Поддерживает Advantech iManager3.0, встроенные программные API, WISE-DeviceOn и Edge AI Suite



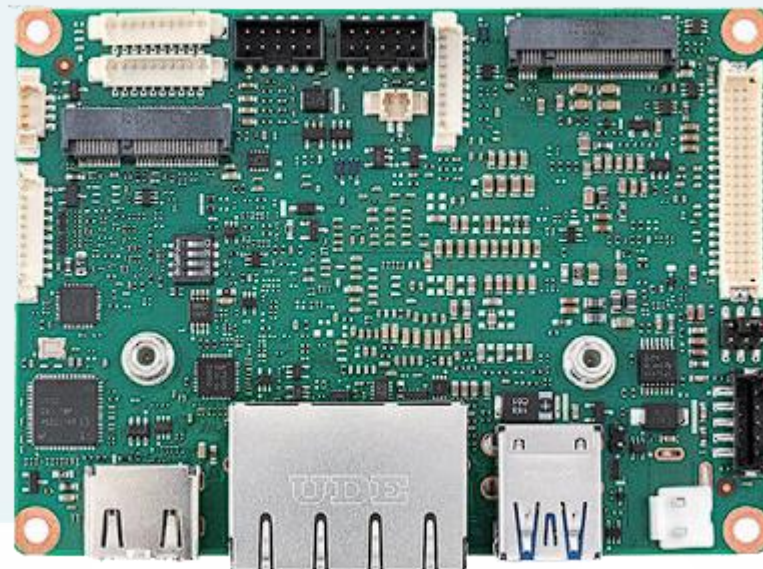
ADVANTECH



# MIO-2363

## Atom x6000E Series PICO-ITX SBC

- Серия Intel Atom x6000E
- Встроенный LPDDR4x до 8 ГБ и EMMC до 128 ГБ
- Поддержка широкого диапазона напряжений 12-24 В при рабочей температуре от -40 до 85 °C
- 2x GbE LAN, 2x USB3.2, 2x RS-232/422/485, I2C
- M.2 E, M.2 B для хранения данных SATA и возможность поддержки модуля RS-232
- Поддержка iManager и программных API, WISE-DeviceOn и EdgeAI Suite



# MIO-5850

Intel® Celeron J1900 & Atom™ E3825/ E3845, 3.5"  
SBC

- Intel® Celeron J1900 и Atom™ E3825/E3845, DDR3L-1333 МГц 2/4 Гб на борту
- Конструкция ЦП снизу вверх для системной интеграции и надежная конструкция для различных производственных сред автоматизации
- 3 Intel i210 GbE, богатый ввод-вывод: 4COM, SATA, USB3.0, SMBus / I2C, 16-битный GPIO, полноразмерный Mini PCIe / M.2 E, половинный размер mSATA, вход питания 12-24 В, держатель SIM-карты, CANBUS с изоляцией
- Поддерживает iManager, SUSI API, WISE-Device On и Edge AI Suite



GPIO



SMBus/I2C



Watch Dog  
Timer



Backlight  
On/Off



Brightness



CAN bus



Hardware  
Monitor



System  
Throttling



Thermal  
Protection



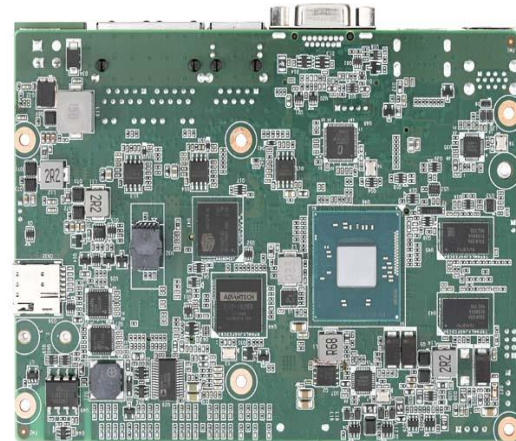
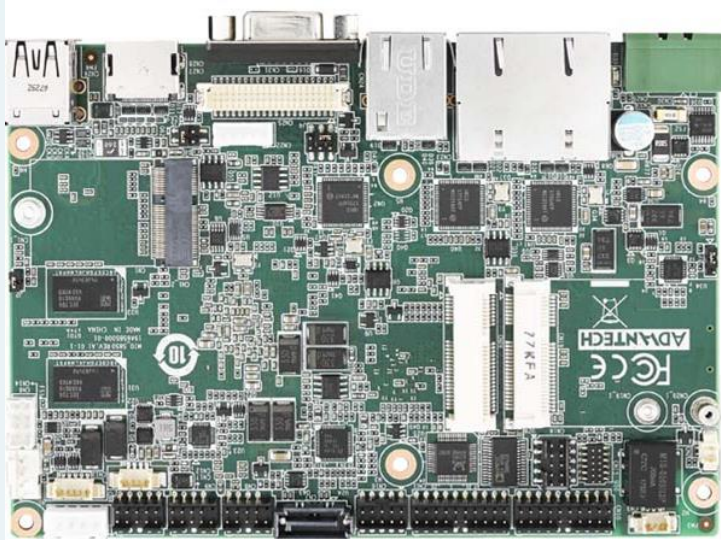
Smart Fan



Data  
Security



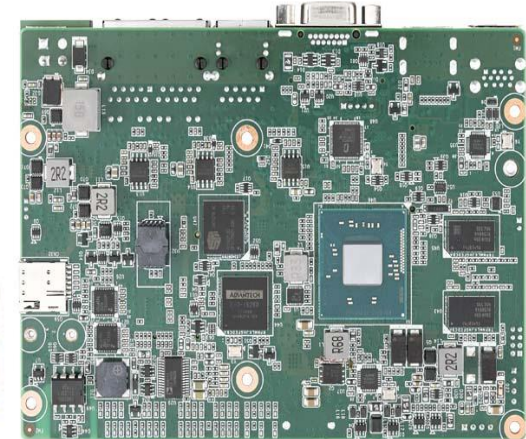
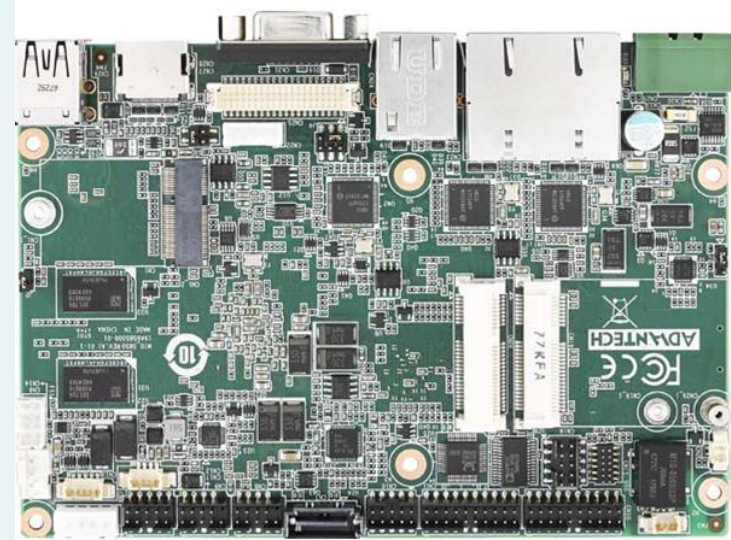
System Info



ADVANTECH

# Широкие возможности подключения

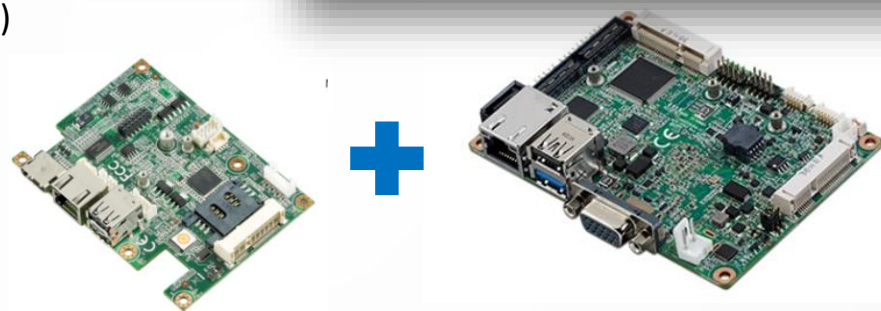
- 3 GbE порта,
- 1 x CAN Bus с 15KV изоляцией
- 1 x USB3.0
- 5 x USB2.0
- 4 x COM ports
- 16-bit GPIO





# Автоматизация завода – «Рука робота»

- Применение: Механический манипулятор
- Модели: **MIO-2263** + **MIOe-120**
- Ключевые функции
  - 3 x GbE
    - EtherCAT
    - Удаленный контроль пульта управления
    - WAN
  - MIOe
    - PCIe to FPGA (карта управления движением)
- Ключевые факторы
  - Плотность расширений MIOe
  - Серийные модули расширения
  - Сервис Design-in





# Система «умной парковки»

- Применение: Распознаватель карт
- Модель: **MIO-5271** с i5-4300U + **EPC-C300**
- Ключевые функции
  - 4 x RS-232
  - mSATA
  - Готовый серийный корпус
- Ключевые факторы
  - Маленький типоразмер
  - Готовый и удобный корпус
  - Для применения “outdoor”



# Установка биологической очистки

- Применение: Биореактор
- Модель: **MIO-5251 + MIOe-210**
- Ключевые функции
  - Разъём расширения MIOe
  - 8-10 COM ports
  - Поддержка Linux
- Ключевые факторы
  - Серийный модули расширения
  - Поддержка кастомизированного BIOS
  - Поддержка языка



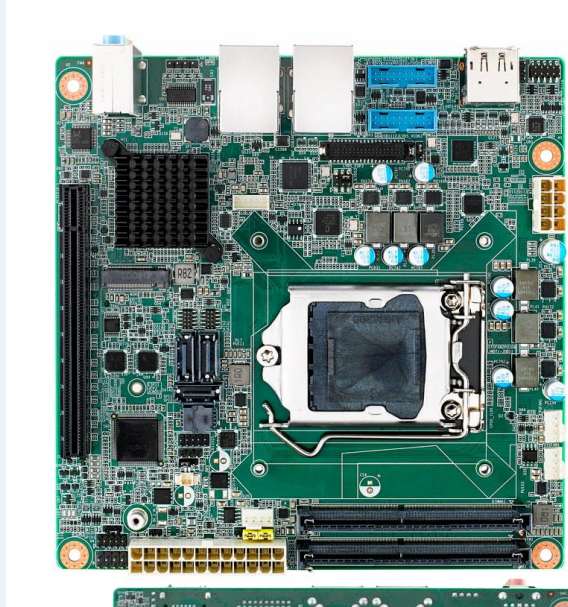
# AIMB



# ASMB-277

Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 10-го поколения LGA 1200  
Mini-ITX

- Поддерживает процессор Intel® Core™ i 10-го поколения (LGA 1200) с чипсетом Intel Q470E
- Два 260-контактных SO-DIMM до 64 ГБ DDR4 2933 МГц SDRAM
- Поддерживает тройной дисплей HDMI 2.0a / DP++ / VGA / LVDS (или eDP)
- Поддерживает PCIe x16 (Gen 3), 1x M.2 М ключ + 1x M.2 Е ключ, 4x USB 3.2 Gen2 + 4x USB 3.2 Gen1 и 4x SATA III
- Поддерживает Intel vPro, AMT, Программный RAID 0,1,5,10, TPM 2.0, Усилитель мощностью 3,2 Вт
- Поддерживает питание ATX
- Поддержка SUSI, WISE-DeviceOn и Edge AI Suite.



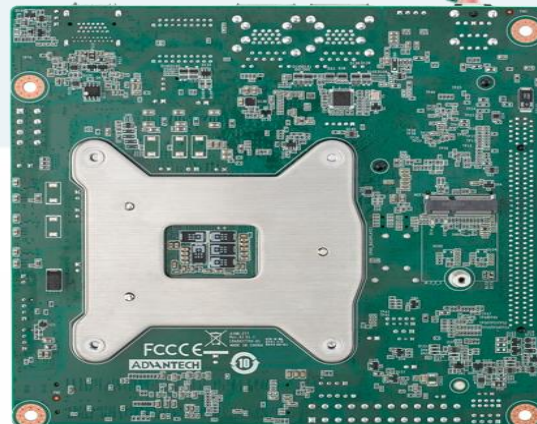
ADVANTECH



# ASMB-587

Intel® Xeon® 10th Gen Core™ i9/i7/i5/i3 LGA  
1200, microATX

- Поддерживает процессор Intel® 10th Gen Xeon/ Core™ i9/i7/i5/i3 с чипсетом Q470E/ W480E/ H420E
- Четыре разъема U-DIMM поддерживают до 128 ГБ SDRAM DDR4 2666/2933 МГц
- Поддерживает 2 DP ++, VGA (опция), eDP-дисплей с поддержкой тройного дисплея
- Поддерживает Intel AMT 12.0 и Intel vPro.
- Поддерживает PCIE Gen3, Dual 10 GbE LAN, Dual GbE LAN, M.2 (M-key) и до 8 x SATA III
- Поддерживает 4 USB3.2 Gen2, 6 USB3.1 Gen1 и 6 USB2.0
- Поддерживает SUSI, WISE-DeviceOn и Edge AI Suite



# AIMB-233

Intel® Core/Celero Mini-ITX с Type C  
Alt./HDMI/LVDS(eDP), 6 COM,

- Поддерживает Intel® Core™ core i7-8665UE /i5-8365UE/i3-8145UE/Celereon
- Два 260-контактных SO-DIMM до 64 ГБ DDR4 2400 МГц SDRAM
- Ввод-вывод с несколькими дисплеями поддерживает универсальные функции Tri display для HDMI
- Поддержка PCIe x1, 2 M.2 (1 F/S miniPCIe), 4 USB 3.1, 2 USB 3.0 и 2 SATA III
- Поддержка широкого диапазона входного тока 12 В ~ 24 В
- Поддержка SUSI, WISE-DeviceOn и Edge AI SuiteInput



SMBus



H/W Monitor



Watchdog



GPIO



Brightness



BIOS flash



Monitoring



ADVANTECH

# ASMB-218

intel® Pentium/Celeron Четырехъядерный / двухъядерный Mini-ITX

- Поддерживает процессор Intel Pentium/Celeron N6210/N6211/J6412/J6413 /J6426/x6413E
- Два 260-контактных SO-DIMM до 32 ГБ DDR4 3200 МГц SDRAM
- Поддержка DP++, HDMI, eDP (или LVDS)
- Поддерживает 1x M.2 (B-Key) и 1x M.2 E-Key (или 1x PCIe), 6 COM, 3 USB 3.2 Gen 2 и 5 USB 2.0, dual LAN.
- Более низкая общая стоимость владения благодаря поддержке DC12V и встроенному TPM2.0 (опция) и усилителю (опция)
- Поддержка SUSI, WISE-DeviceOn и Edge AI Suite.



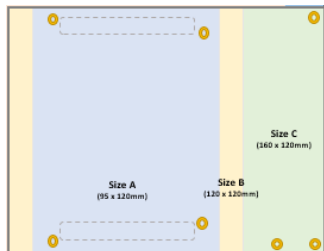
# SOM





# COM-NPC Целевой рынок

Сеть 5G, Искусственный интеллект, Экстренная помощь



**COM-NPC**  
Клиент

Медицина



Промышленная  
автоматизация



Экстренная помощь



Роботы с искусственным  
интеллектом



**Интегрированный процессор и графика, а также сверхскоростное расширение ввода-вывода для различных требований**

Сеть



Коммуникация



Вооруженные силы



Испытательное  
оборудование



**COM-NPC**  
Сервер

**Производительность серверного уровня и интегрированная локальная сеть 10G улучшают масштабируемость системы.**

**ADVANTECH**

# SOM-D580

Процессор Intel® Xeon® D2700 (Ice Lake-DHCC)

Модуль COM-HPC® серверного размера

- Модуль COM-HPC® Server Размером D
- Процессоры Intel® Xeon® D-2700
- До 20 ядер, кэш-память 30 Мбайт, TDP 118 Вт
- Четырехканальный DDR4-3200 RDIMM /LRDIMM до 512 ГБ (как ECC, так и не ECC)
- 32 x PCIe Gen 4, 17 x PCIe Gen 3, 4 x 25GBASE-KR, IPMB
- Поддерживает manager, встроенные программные API и WISE-DeviceOn



Watchdog



I²C



SMBus



H/W Monitor



GPIO



BIOS flash



Monitoring



Embedded Security ID



ADVANTECH

# SOM-6883

Процессор Intel® Core 11-го поколение COM  
Express® Compact Type6

- Процессор Intel® Core 11-го поколение U-серии
- Компактный модуль COM Express R3.0 Type 6
- Двухканальный с одной отключенной памятью и одним SO-DIMM
- Высокоскоростной ввод-вывод: 1 PCIe x4 Gen4, 5 PCIe x1 Gen3, 4 USB3.2 Gen2
- Встроенный твердотельный накопитель NVMe x4 объемом до 64 ГБ, TPM2.0



Watchdog



I2C



SMBus



H/W Monitor



GPIO



Brightness



Windows Embedded

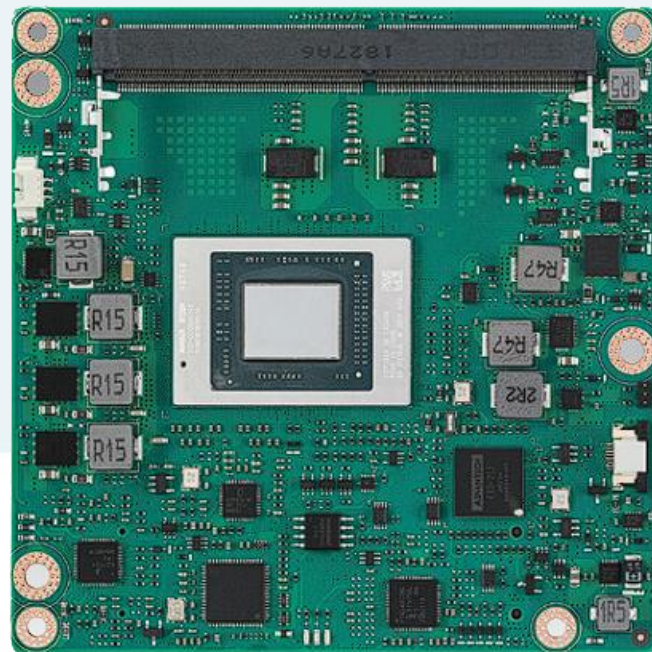


ADVANTECH

# SOM-6872

Встроенный модуль AMD Ryzen V2000 COM  
Express® Compact Type 6

- Встроенный процессор AMD Ryzen 7nm SoC – V2000 APU
- COM Express® R3.0 Type 6
- Двухканальный DDR4 SODIMM, макс. 64 ГБ (как ECC, так и без ECC)
- Высокоскоростной ввод-вывод: 2 USB 3.2 Gen2, 1 PCIe x8 Gen3, 8 PCIe x1 Gen 3 и 2 SATA3.0
- Четыре дисплея (DP++, HDMI, VGA, LVDS)
- Поддерживает iManager, встроенные программные API и MIPSE DeviceOn





# SOM-2569

Модуль Intel® Pentium®/Celeron® серии N4200 и  
Atom серии SMARC

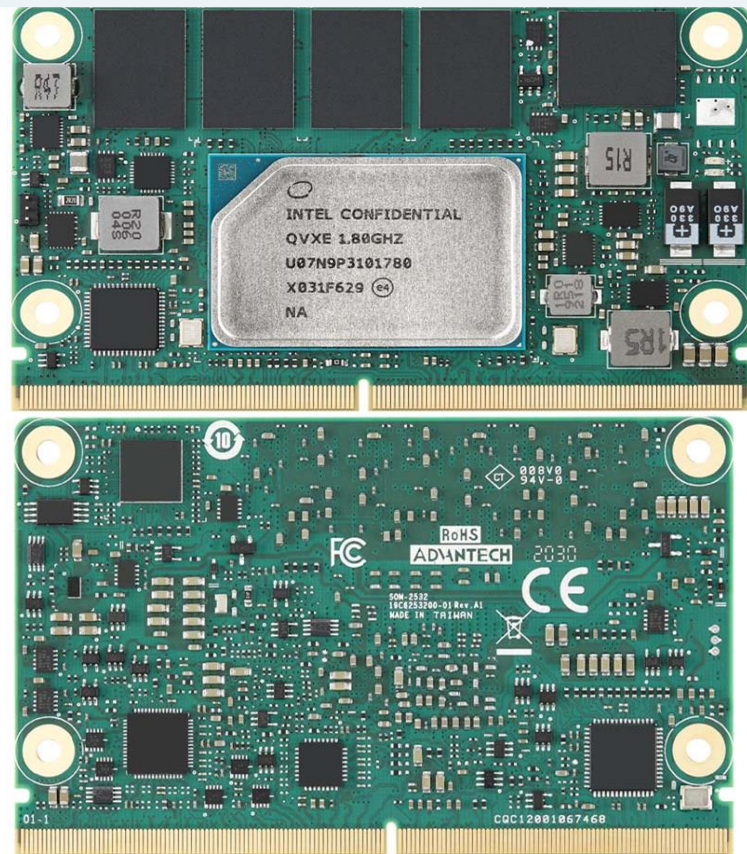
- Соответствие требованиям SMARC2.0 и SMARC2.1
- Процессоры Intel® Atom™ E3900 / Pentium® / Celeron® серии N
- Встроенный двойной GbE. конструкция беспроводного модуля на борту
- Двухканальный LPDDR4 2/4/8 ГБ оперативной памяти и встроенный eMMC
- Тройной дисплей (DP++, HDMI, LVDS)
- Поддерживает iManager, WISE-PaaS/DeviceOn и встроенное программное обеспечение



# SOM-2532

Модуль Intel® Pentium®/Celeron® and Atom®  
x6000 Series

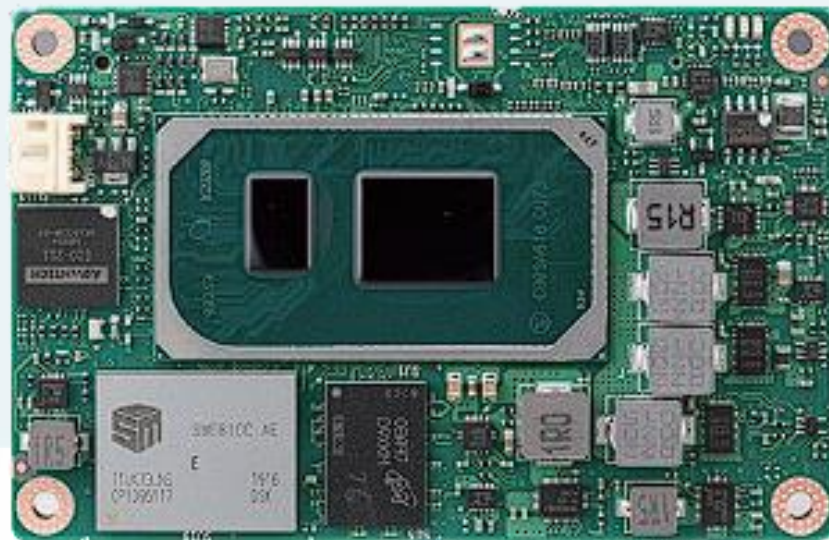
- Процессоры Intel Atom® x6000, Pentium® и Celeron® серии x6000
- Распиновка SMARC2.1.1, небольшой размер
- Двухканальный LPDDR4 3200 мбит/с до 16 ГБ, поддержка IB ECC
- Тройные дисплеи до 4K (DP++, HDMI, LVDS/eDP/MIPI-DSI)
- Множественное расширение ввода-вывода: PCIe gen3, USB3.2 Gen2, USB2.0, SATA
- Встроенный eMMC 32 ГБ
- Поддерживает iManager, встроенные программные API и Wise-DeviceOn



# SOM-7583

Процессоры Intel® Core 11-го Поколения COM  
Express Mini Module Type10

- COMe Mini Type-10
- Процессоры Intel® Tiger Lake UP3
- 16 ГБ LPDDR4X 4266 мбит/с и поддержка IBEEC
- Соответствие USB4 поддерживается конструкцией несущей платы
- Встроенный твердотельный накопитель NVMe
- Рабочие температуры: Стандартные 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) или расширенные -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
- Поддерживает SUSI, Device On и Edge AI Suite

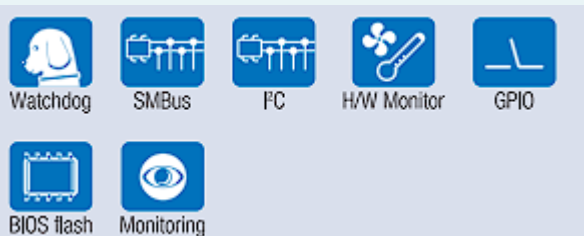




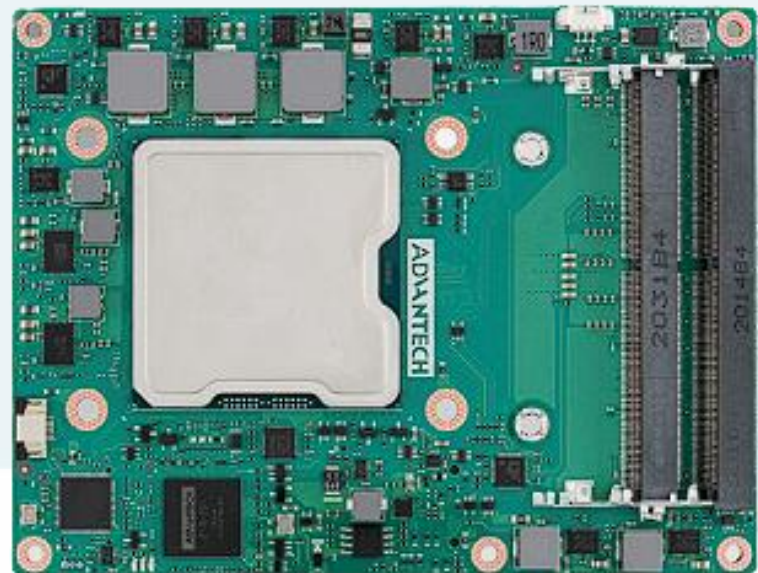
# SOM-5993

Процессор Intel® Xeon® D-1700 COM Express®  
Basic Type7

- Процессоры Intel® Xeon® D-1700
- COM Express R3.0 Базовый модуль Type 7
- 4 ~ 10-ядерный процессор, с макс. TDP 67 Вт
- Высокоскоростной Ethernet (4 интерфейса x 10GBASE-KR, один GbE)
- Различные расширения (PCIe x16 Gen 4, PCIe X8, 4PCIe X1, 4 USB3.0, 2 SATA3)
- Поддерживает SUSI, DeviceOn и Edge AI Suite



Windows Embedded



ADVANTECH



# Co-Creating the Future of the IoT World



Advantech  
Embedded IoT  
& Service IoT  
Россия и СНГ



Advantech  
Россия и  
СНГ



[ARU.embedded@advantech.com](mailto:ARU.embedded@advantech.com)

8(800)555-01-50

